RSC'd T/PTO 13 JAN 2005

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



T TERRE TERRETO TE ATERIA DEPE CENTE ATERI ETTE E UNI ALBERTURE ATERIA DEL ANTONIO PER ATERIA DEL RESERVACIONE

(43) 国際公開日 2004 年1 月29 日 (29.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/010223 A1

(51) 国際特許分類⁷: G03F 7/075, 7/004, H01L 21/027, C08G 77/54, 77/62

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/006613

(22) 国際出願日:

2003年5月27日(27.05.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-209957 2002年7月1

2002年7月18日(18.07.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): クラリアントインターナショナルリミテッド(CLARIANT INTERNATIONAL LTD) [CH/CH]; CH-4132 ムッテンツ1 ロートハウスシュトラーセ 6 1 Muttenz (CH).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長原 達郎 (NA-GAHARA, Tatsuro) [JP/JP]; 〒113-8662 東京都文京区本駒込二丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP). 松尾 英樹 (MATSUO, Hideki) [JP/JP]; 〒113-8662 東京都文京区本駒込二丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI,Atsushi et al.); 〒105-8423 東京都港区虎ノ門 三丁目 5番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビ ル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[続葉有]

(54) Title: PHOTOSENSITIVE COMPOSITION FOR INTERLAYER DIELECTRIC AND METHOD OF FORMING PATTERNED INTERLAYER DIELECTRIC

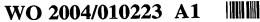
(54) 発明の名称: 層間絶縁膜用感光性組成物及びパターン化層間絶縁膜の形成方法

(57) Abstract: A photosensitive composition which has excellent storage stability and gives an interlayer dielectric having an improved thickness limit. The photosensitive composition is characterized by comprising: a modified polysilsesquiazane which is obtained by replacing up to 50 mol% of basic structural units represented by the general formula -[SiR¹(NR²)_{1.5}]- (wherein R¹'s each independently represents C_{1.3} alkyl or (un)substituted phenyl; and R²'s each independently represents hydrogen, C_{1.3} alkyl, or (un)substituted phenyl) by connecting groups other than silazane bonds and which has a weight-average molecular weight of 500 to 200,000; and a photo-acid generator.

(57) 要約:

保存安定性に優れ、得られる層間絶縁膜の膜厚限界が向上する感光性組成物を提供する。本発明による感光性組成物は、一般式:一 [SiR¹(NR²)」。]ー(式中、R¹は、各々独立に、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)を基本構成単位とし、その最大で50モル%をシラザン結合以外の結合基に代替してなる重量平均分子量500~200,000変性ポリシルセスキアザン及び光酸発生剤を含むことを特徴とする。

7O 2004/010223 A1 IIII





添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



明 細 書

層間絶縁膜用感光性組成物及びパターン化層間絶縁膜の形成方法

技術分野

本発明は、感光性組成物、特に光による高解像度微細パターニング加工が可能な膜を形成しうる光分解性ポリシルセスキアザン組成物の改良、並びにこのような組成物を用いてパターン化層間絶縁膜を形成する方法に関する。

背景技術

半導体デバイスや液晶表示装置の製作においては、層間絶縁膜が 用いられている。一般に層間絶縁膜は、塗布もしくは気相から堆積 されたのちフォトレジストを介してエッチングされることによりパ ターン形成がなされる。しかしながら、微細なパターンの場合、エ ッチングには気相エッチングが用いられるが、装置コストが高く、 処理速度が遅いという問題があった。

一方、層間絶縁膜にはデバイス製作工程中に400℃を超えるような高温に晒されるため、一般的なレジストに用いられるような有機樹脂ではその用に耐えない。かかる材料としては、パターン化されたシリカ系セラミックス膜が、耐熱性の他、耐磨耗性、耐蝕性、絶縁性、透明性、等にも優れた被膜として半導体デバイス、液晶表示装置、プリント回路基板、等において有用であることが知られている。

特に、パターン化された被膜を層間絶縁膜として残留させて使用する場合には、低誘電率である被膜であることが望まれる。かかる要請に応えるべく、特開2000-181069号公報において、



ポリシラザンと光酸発生剤とを含む感光性ポリシラザン組成物の塗膜を形成する工程と、前記塗膜に光をパターン状に照射する工程と、前記塗膜の照射された部分を溶解除去する工程とを含んで成る、パターン化されたポリシラザン膜の形成方法及び当該パターン化されたポリシラザン膜を、周囲雰囲気において放置又は焼成することによりシリカ系セラミックス被膜に転化させる工程を含んで成る、パターン化された絶縁膜の形成方法が開示されている。

さらに、本件出願人は、特定の変性ポリシルセスキアザンと光酸 発生剤とを含む感光性組成物に形状安定化剤として水溶性化合物を 添加することにより解像度を高めることができ、しかも誘電率、機 械的特性に優れた特性を有する層間絶縁膜の微細化したパターンの 形成できることを見出し、特願2000-297107号として提 案した。すなわち、一般式:- [SiR 1 (NR 2) $_{1.5}$] -を基 本構成単位とし、さらに一般式: - [SiR¹ 2NR²] - 及び/ 又は [SiR¹₃ (NR²)_{0.5}] -で表される他の構成単位を前 記基本構成単位に対して0.1モル%~100モル%含有する数平 均分子量100~100,000変性ポリシルセスキアザン(前 記式中、R¹ は、各々独立に、炭素数1~3のアルキル基又は置換 もしくは無置換フェニル基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭 素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)と、光酸発生剤と、形状安定化剤として水溶性化合物とを含んで 成る層間絶縁膜用感光性組成物、並びに上記層間絶縁膜用感光性組 成物の塗膜を形成し、当該塗膜に光をパターン状に照射し、当該塗 膜の照射された部分を溶解除去し、そして残留したパターン化塗膜 を周囲雰囲気において放置又は焼成することを特徴とするパターン 化層間絶縁膜の形成方法を提案した。

上述したような感光性組成物を用いることにより、気相エッチン



グが不要となり、微細なパターンを有する層間絶縁膜を低コストで 形成することができる。一方、特開2000-181069号公報 に記載の感光性組成物には保存安定性に問題がある。また、これら の感光性組成物により形成された層間絶縁膜は、膜を厚くするとク ラックが発生しやすくなるため、その膜厚限界の向上が望まれる。 その際、感光性組成物の感光性や、得られる層間絶縁膜の硬度が損 なわれないことも要求される。

発明の開示

本発明者は、上記課題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、ポリシルセスキアザンの構成単位の一部をシラザン結合以外の結合基に代替することにより、感光性や得られる層間絶縁膜の硬度を損なわずに、感光性組成物の保存安定性を高めることができ、さらに当該代替結合基を選択することにより、得られる層間絶縁膜の膜厚限界を高められることを見出し、本発明に到達した。

以下、本発明の構成を列挙する。

- [1] 一般式: [SiR¹(NR²)_{1.5}] (式中、R¹は、各々独立に、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)を基本構成単位とし、その最大で50モル%をシラザン結合以外の結合基に代替してなる重量平均分子量500~200,000の変性ポリシルセスキアザン及び光酸発生剤を含むことを特徴とする層間絶縁膜用感光性組成物。
- [2] 前記変性ポリシルセスキアザンが、さらに一般式: [S i R 3 $_2$ N R 2] 及び/又は [S i R 3 $_3$ (N R 2) $_{0.5}$] (式中、R 3 は、各々独立に、水素、炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基又



は置換もしくは無置換フェニル基を表し、R² は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)で表される他の構成単位を前記基本構成単位に対して0.1モル%~100モル%含有する、[1]項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。

[3] 前記結合基が下記一般式(I):

$$\begin{array}{c|c}
R^4 \\
S & i \\
R^5
\end{array}$$
(I)

(式中、R⁴ 及びR⁵ は、各々独立に、水素、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルキルシリル基又はアルコキシ基を表し、pは1~10の整数を表す)で表される、[1] 又は[2] 項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。

[4] 前記結合基が下記一般式(II):

(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルキルシリル基又はアルコキシ基を表し、R¹⁰は酸素原子、アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、アルキルイミノ基又はアルキルシリレン基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換



もしくは無置換フェニル基を表し、 q は 1 ~ 1 0 の整数を表す)で表される、 [1] 又は [2] 項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物

- [5] R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹がメチル基であり、R¹⁰がフェニレン基であり、R²が水素であり、そしてqが1である、[4]項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- [6] 前記光酸発生剤がスルホキシム系化合物及びトリアジン系化合物からなる群より選ばれたものである、[1] ~ [5] のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- [7] さらに t ーブトキシカルボニル化カテコール、 t ーブトキシカルボニル化ヒドロキノン、ベンゾフェノンー4, 4'ージカルボン酸 t ーブチルエステル及び4, 4'ーオキシジ安息香酸 t ーブチルエステルからなる群より選ばれた溶解防止剤を、前記感光性組成物に対して0.1~40質量%含む、[1]~[6]のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- [8] さらに形状安定化剤としてニトロ基又は炭酸エステルを含有する水溶性化合物を含む、[1]~[7]のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- [9] さらに増感色素を含む、〔1〕~〔8〕のいずれか1項に 記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- [10] 一般式: $-[SiR^1(NR^2)_{1.5}]$ $-(式中、R^1)$ は、各々独立に、炭素数 $1\sim3$ のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、 R^2 は、各々独立に、水素、炭素数 $1\sim3$ のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)を基本構成単位とし、その最大で50 モル%をシラザン結合以外の結合基に代替してなる重量平均分子量 $500\sim200$, 000 の変性ポリシルセスキアザン及び光酸発生剤を含む層間絶縁膜用感光性組成物の塗



膜を形成し、前記塗膜に光をパターン状に照射し、前記塗膜の照射された部分を溶解除去し、そして残留したパターン化塗膜を周囲雰囲気において放置又は焼成することを特徴とするパターン化層間絶縁膜の形成方法。

以下、本発明について詳しく説明する。

発明を実施するための最良の形態

本発明による層間絶縁膜用感光性組成物はポリシルセスキアザン 系のポジ型フォトレジストである。このような感光性組成物は、パ ターン状に照射を受けた感光性組成物の塗膜の露光部分でポリシル セスキアザンのSi-N結合が開裂し、さらに周囲雰囲気中の水分 と反応することによりシラノール(Si-OH)結合が生成する。 すなわち、照射後の塗膜を現像することにより、感光性組成物の露 光部分が溶解除去され、未露光部分が基板上に残留してパターン(ポジ型)が形成される。このように、ポリシルセスキアザン系ポジ 型フォトレジストの感光性は、その基本構成単位であるSi-N結 合が担うため、その一部をシラザン結合以外の結合基に代替すると 、露光により開裂する部位であるSi-N結合数が減少することに より、当該高分子自体の感光性は低下するものと考えられる。しか しながら、その後の現像処理においては、すべてのSi-N結合が Si-〇H結合に転化されていなくても、露光部分が、複数の基本 構成単位からなる塊として、完全に除去されることがわかった。す なわち、ポリシルセスキアザンの基本構成単位の一部をSi-N結 合以外の非感光性の結合に代替しても、露光部分の除去性を損なう ことなく、そのフォトレジストとしての感光性を十分に確保するこ とができることがわかった。本発明は、かかる所見に基づき、感光 性組成物のフォトレジストとしての感光性を損なわない範囲でポリ



シルセスキアザンを変性させることにより、感光性組成物の保存安 定性を高め、さらにそのセラミックス化により得られる層間絶縁膜 の膜厚限界を、高い硬度を維持しつつ向上させたものである。

本発明による層間絶縁膜用感光性組成物に含まれる変性ポリシルセスキアザンは、一般式:一 $\{SiR^1(NR^2)_{1.5}\}$ 一を基本構成単位とし、その最大で50 モル%をシラザン結合以外の結合基に代替してなる。ここで、 R^1 は、各々独立に、炭素数 $1\sim3$ のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、 R^2 は、各々独立に、水素、炭素数 $1\sim3$ のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す。 R^1 はメチル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す。 R^1 はメチル基又はフェニル基であることが好ましい。また、 R^2 は水素であることが好ましい。

上記基本構成単位の最大で50モル%を代替する結合基としては 、下記一般式(I):

$$\begin{array}{c|c}
R^4 \\
\hline
S & i \\
\hline
P & p
\end{array}$$
(I)

(式中、R⁴ 及びR⁵ は、各々独立に、水素、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルキルシリル基又はアルコキシ基を表し、pは1~10の整数を表す)で表されるものが挙げられる。このような結合基で上記基本構成単位を代替することにより、感光性組成物の保存安定性が向上する。これは、三官能形の基本構成単位のみからなるポリシルセスキアザンの場合には、分子内に歪みのある環構造が多数存在し、これが保存時に開裂し、その開裂した部分が他の同様に



開裂した分子と再結合することにより分子量が高くなるが、該基本構成単位の一部をシラザン結合以外の結合基に代替すると、歪みのある環構造が減少するためこのような開裂・再結合による高分子量化が抑えられるためであると考えられる。

上記 R^4 及び R^5 は、炭素数 $1\sim7$ 、好ましくは $1\sim5$ 、より好ましくは1又は2のアルキル基、炭素数 $2\sim7$ のアルケニル基、炭素数 $5\sim7$ のシクロアルキル基、及びアリール基であることが一般的である。より具体的には、フェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、ベンジル基、フェネチル基、 α ーメチルベンジル基、ベンズヒドリル基、トリチル基、スチリル基、シンナミル基、ビフェニル基、ナフチル基、等が挙げられる。さらに、アルキルシリル基(モノ、ジ又はトリー置換体)、アルキルアミノ基(モノ又はジー置換体)及びアルコキシ基としては、通常、炭素数 $1\sim7$ のものが使用される。なお、 R^4 と R^5 は同一であってもよいし、それぞれ異なっていてもよい。pは $1\sim5$ であることが好ましく、最も好ましくは2である。

さらに本発明によると、上記の結合基として下記一般式(II):

$$\begin{array}{c|c}
 & R^{6} \\
\hline
 & S & i \\
\hline
 & R^{10} \\
\hline
 & q \\
\hline
 & R^{9}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & R^{8} \\
\hline
 & I \\
\hline
 & R^{2} \\
\hline
 & R^{9}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & II \\
\hline
 & II \\
\hline
 & R^{9}
\end{array}$$

(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルキルシリル基又はアルコキシ基を表し、R¹⁰は酸素原子、アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、アルキルイミノ基又はアルキルシリレン基を表し、アリーレン基、アルキルイミノ基又はアルキルシリレン基を表し



、R² は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、qは1~10の整数を表す)で表されるものを使用することにより、上述したように感光性組成物の保存安定性を高めることができる上、得られる層間絶縁膜の膜厚限界をその硬度を損なうことなく高めることができる。

上記R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、炭素数1~7、好ましくは1 ~5、より好ましくは1又は2のアルキル基(特に、メチル基)、 炭素数 2 ~ 7 のアルケニル基、炭素数 5 ~ 7 のシクロアルキル基、 及びアリール基であることが一般的である。より具体的には、フェ ニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、ベンジル基、フェネ チル基、α-メチルベンジル基、ベンズヒドリル基、トリチル基、 スチリル基、シンナミル基、ビフェニル基、ナフチル基、等が挙げ られる。さらに、アルキルシリル基 (モノ、ジ又はトリー置換体) 、アルキルアミノ基(モノ又はジー置換体)及びアルコキシ基とし ては、通常、炭素数1~7のものが使用される。なお、R⁶、R⁷ 、R®及びR®は同一であってもよいし、それぞれ異なっていても よい。 R^{10} は炭素数 $1\sim7$ 、好ましくは $1\sim5$ 、より好ましくは1又は2のアルキレン基、炭素数2~7のアルケニレン基、炭素数5 ~7のシクロアルキレン基、アリーレン基、炭素数1~7のアルキ ルイミノ基又は炭素数1~7のアルキルシリレン基であることが一 般的である。より具体的には、フェニレン基、トリレン基、キシリ レン基、ベンジリデン基、フェネチリデン基、αーメチルベンジリ デン基、シンナミリデン基、ナフチレン基、等が挙げられる。特に 好ましいアリーレン基はフェニレン基である。R² は水素であるこ とが好ましい。aは1~5であることが好ましく、最も好ましくは 1である。

シラザン結合以外の結合基は、ポリシルセスキアザンの基本構成



単位の最大で50モル%を代替する。本発明による感光性組成物の保存安定性が向上し、該結合基によってはさらに膜厚限界が向上するという本発明の効果は、該結合基が存在することにより得られることから、技術思想として当該代替比率の下限値を定める必要はない。しかしながら、本発明の効果を十分に得るためには、当該代替比率を一般に0.1モル%以上、好ましくは1モル%以上、とすることが適切である。一方、当該代替比率の上限値は、層間絶縁膜用感光性組成物に望まれる感光性が損なわれないように、一般に50モル%以下、好ましくは45モル%以下、より好ましくは40モル%以下、とすることが適切である。なお、本発明による変性ポリシルセスキアザンは、上記一般式(I)の結合基と上記一般式(II)の結合基とが混在していてもよい。

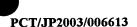
これらの他の構成単位は該基本構成単位に対してランダムに結合 される。 R^1 、 R^2 、 R^3 のいずれについても、具体的な基は各々 独立に選ぶことができ、したがって、基本構成単位間で同一であっ



ても異なってもよく、また基本構成単位と他の構成単位との間でも同一であっても異なってもよい。例えば、基本構成単位においてR1の一部がメチルであり、その残部がフェニルであること、R2の一部が水素であり、その残部がメチルであること、また基本構成単位のR1がメチルであり、他の構成単位のR3がメチル又はフェニルであること、基本構成単位のR2が水素であり、他の構成単位のR3が水素又はメチルであること、等、いずれも可能である。好ましくは、基本構成単位及び他の構成単位の両方において、R1とR3はメチル基又はフェニル基であり、特にメチル基であることが最も好ましい。また、基本構成単位及び他の構成単位の両方において、R2は水素であることが好ましい。

上記他の構成単位を含む変性ポリシルセスキアザンは、一般式: $-[SiR^3_2]NR^2]$ -DEU/Vは $[SiR^3_3]$ $(NR^2)_{0.5}$] - で表される他の構成単位を上記基本構成単位に対して0.1 モル%~100 モル%、好ましくは0.5 モル%~40 モル%、より好ましくは1 モル%~20 モル%含有する。他の構成単位として一般式: $-[SiR^3_2]NR^2]$ - のみを含有する場合には、上記基本構成単位に対する含有量は0.1 モル%~100 モル%、より好ましくは1 モル%~20 モル%であることが好ましい。また、他の構成単位として一般式: $[SiR^3_3](NR^2)_{0.5}]$ - のみを含有する場合には、上記基本構成単位に対する含有量は0.1 モル%~50 モル%、より好ましくは0.5 モル%~20 モル%であることが好ましい。なお、他の構成単位が100 モル%であることが好ましい。なお、他の構成単位が100 モル%よりも多いと、ポリマーの分子量が十分に高くならないために塗膜に流動性が生じ、好ましくない。

本発明による変性ポリシルセスキアザンの重量平均分子量は500~200,000、好ましくは600~150,000範囲に



ある。変性ポリシルセスキアザンの重量平均分子量が500よりも低いと塗膜に流動性が生じ、反対に200,000よりも高いと溶媒への溶解が困難となり、いずれも好ましくない。

本発明による変性ポリシルセスキアザンは、通常のポリシラザン を合成する際のアンモノリシスにおいて、出発原料としてR1 Si Claと、シラザン結合以外の結合基が誘導され得るモノマーとを 、後者を当該結合基の代替比率に対応するモル比率で使用すること により容易に得られる。例えば、当該結合基として上記一般式(Ⅰ) の結合基を含有させる場合には、R¹ SiCl₃ にCl (Si (R^4) (R^5) O) p S i (R^1) C l 2 を混合したシラン原料を 用いてアンモノリシスを行えばよい。この場合、当該結合基の代替 比率に対応するモル比率を計算する際には、後者の原料のSi(R 1) C1。部分が基本構成単位側に組み込まれるため、当該モノマ ー中の数値 p を考慮する必要がある。例えば、 p = 1 の場合、 R¹ $SiCl_3 \& ClSi(R^4)(R^5)OSi(R^1)Cl_2 \& 1$ 対1のモル比率で混合すると、当該結合基の代替比率は約33%と なる。また、p=2の場合、R¹ SiCl₃ とCl(Si(R⁴) (R⁵) O)₂ Si (R¹) Cl₂ を2対1のモル比率で混合する と、当該結合基の代替比率は40%となる。一方、当該結合基とし て上記一般式 (II) の結合基を含有させる場合には、R¹SiCl₃ とCl (Si (R⁶) (R⁷) R¹⁰) _a Si (R⁸) (R⁹) C 1を、q値とは関係なく、当該結合基の代替比率に対応するモル比 率で混合してアンモノリシスを行えばよい。例えば、前者と後者を 9対1のモル比率で混合すると、当該結合基の代替比率は10%と なる。

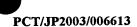


原料として R^1 SiCl₃、 R^1 ₂ SiCl₂及び/又は R^1 ₃ SiClを、後二者を上記他の構成単位の含有比率に対応するモル比率で使用することにより容易に得られる。例えば、他の構成単位として一般式:- [Si R^1 ₂ N R^2] - を 2 0 モル%含有させる場合には、 R^1 SiCl₃に対して 2 0 モル%の R^1 ₂ SiCl₂を混合したシラン原料を用いてアンモノリシスを行えばよく、同様に、他の構成単位として一般式: [Si R^1 ₃ (N R^2)_{0.5}] - を 1 0 モル%含有させる場合には、 R^1 SiCl₃に対して 1 0 モル%の1 3 SiClを混合すればよい。

なお、ポリシラザンを合成する際のアンモノリシスの詳細につい ては、例えば、特公昭63-16325号公報を参照されたい。

本発明による感光性組成物は光酸発生剤を含む。光酸発生剤は、 その固有の感光波長域にある光の照射により直接的に又は、増感色素を使用する場合にはその増感色素が励起される波長域にある光の 照射により間接的に、励起状態にされる。励起状態となった光酸発生剤により変性ポリシルセスキアザンのSi-N結合が開裂し、雰囲気中の水分との反応することによりシラノール(Si-OH)結合が生成するものと考えられる。シラノールは後述の現像液に可溶であるため、感光性組成物の塗膜の光照射部分のみが溶解除去され、ポジ型のパターニングが達成される。

光酸発生剤は過酸化物であることができる。過酸化物系の光酸発生剤の具体例として、3,3',4,4'ーテトラ(tーブチルペルオキシカルボニル)ベンゾフェノン、tーブチルペルオキシベンゾエート、メチルエチルケトンペルオキシド、シクロヘキサノンペルオキシド、メチルアセトアセテートペルオキシド、アセチルアセトンペルオキシド、1,1ービス(tーヘキシルペルオキシ)3,3,5ートリメチルシクロ

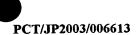


ヘキサン、1, 1-ビス (t-ヘキシルペルオキシ) シクロヘキサ ン、1, 1-ビス (t-ブチルペルオキシ) 3, 3, 5-トリメチ ルシクロヘキサン、ジー t - ブチルペルオキシ-2-メチルシクロ ヘキサン、1, 1-ビス (t-ブチルペルオキシ) シクロヘキサン 、1,1-ビス(t-ブチルペルオキシ)シクロドデカン、2,2 ービス (t-ブチルペルオキシ) ブタン、n-ブチル 4, 4-ビ ス (t-ブチルペルオキシ) バレレート、2,2-ビス(4,4-ジーtーブチルペルオキシシクロヘキシル)プロパン、pーメンタ ンヒドロペルオキシド、ジイソプロピルベンゼンヒドロペルオキシ ド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルヒドロペルオキシド、ク メンヒドロペルオキシド、tーヘキシルヒドロペルオキシド、tー ブチルヒドロペルオキシド、 α , α 'ービス(tーブチルペルオキ シ) ジイソプロピルベンゼン、ジクミルペルオキシド、2,5-ジ メチル-2, 5-ビス (t-ブチルペルオキシ) ヘキサン、t-ブ チルクミルペルオキシド、ジーt-ブチルペルオキシド、2,5-ジメチル-2, 5-ビス (t-ブチルペルオキシ) ヘキシン-3、 イソブチリルペルオキシド、3,5,5-トリメチルヘキサノイル ペルオキシド、オクタノイルペルオキシド、ラウロイルペルオキシ ド、ステアロイルペルオキシド、コハク酸ペルオキシド、mートル オイルベンゾイルペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、ジーn - プロピルペルオキシジカーボネート、ジイソプロピルペルオキシ ジカーボネート、ビス (4-t-ブチルシクロヘキシル) ペルオキ シジカーボネート、ジー2-エトキシエチルペルオキシジカーボネ ート、ジ-2-エチルヘキシルペルオキシジカーボネート、ジ-3. -メトキシブチルペルオキシジカーボネート、ジ(3-メチル-3 -メトキシブチル)ペルオキシジカーボネート、 α , α 'ービス(ネオデカノイルペルオキシ) ジイソプロピルベンゼン、クミルペル



オキシネオデカノエート、1,1,3,3-テトラメチルブチルペ ルオキシネオデカノエート、1-シクロヘキシル-1-メチルエチ ルペルオキシネオデカノエート、t-ヘキシルペルオキシネオデカ ノエート、 t - ブチルペルオキシネオデカノエート、 t - ヘキシル ペルオキシピバレート、 t - ブチルペルオキシピバレート、1, 1 , 3, 3-テトラメチルブチルペルオキシ-2-エチルヘキサノエ ート、2,5-ジメチル-2,5-ビス(2-エチルヘキサノイル ペルオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルペ ルオキシー2-エチルヘキサノエート、t-ヘキシルペルオキシ 2-エチルヘキサノエート、t-ブチルペルオキシ 2-エチルヘ キサノエート、t ーブチルペルオキシイソブチレート、t ーヘキシ ルペルオキシイソプロピルモノカーボネート、tーブチルペルオキ シマレイン酸、 t - ブチルペルオキシ 3, 5, 5 - トリメチルへ キサノエート、t-ブチルペルオキシラウレート、2,5-ジメチ ル-2,5-(m-トルオイルペルオキシ)へキサン、t-ブチル ペルオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブチルペルオキシ 2-エチルヘキシルモノカーボネート、 t-ヘキシルペルオキシ ベンゾエート、2,5-ジメチル-2,5-ビス(ベンゾイルペル オキシ) ヘキサン、t-ブチルペルオキシアセテート、t-ブチル ペルオキシーmートルオイルベンゾエート、ビス(tーブチルペル オキシ) イソフタレート、 t - ブチルペルオキシアリルモノカーボ ネート、t-ブチルトリメチルシリルペルオキシド、1,3-ジ(t-ブチルペルオキシカルボニル)ベンゼン、等が挙げられる。

光酸発生剤は、ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル又はニトロベンジルエステルであることもできる。ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル系の光酸発生剤の具体例として、1,2-ナフトキノン-(2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライド、1,2



- ナフトキノン- (2) - ジアジド- 4 - スルホン酸クロライド、 2、3、4-トリヒドロキシベンゾフェノンと6-ジアゾー5,6 - ジヒドロー5-オキソーナフタレン-1-スルホン酸との(モノ ~トリ) エステル、2, 3, 4, 4'ートリヒドロキシベンゾフェ ノンと6-ジアゾー5,6-ジヒドロー5-オキソーナフタレンー 1-スルホン酸との(モノ~トリ)エステル、等が挙げられる。ニ トロベンジルエステル系の光酸発生剤の具体例として、ニトロベン ジルトシレート、ジニトロベンジルトシレート、ニトロベンジルク ロライド、ジニトロベンジルクロライド、ニトロベンジルブロミド 、ジニトロベンジルブロミド、ニトロベンジルアセテート、ジニト ロベンジルアセテート、ニトロベンジルトリクロロアセテート、ニ トロベンジルトリフルオロアセテート、等が挙げられる。その他の 光酸発生剤としてベンゾイントシレート、ニトロベンジルスルホン 酸類、オニウム塩類〔例えば、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨ ードニウム塩やトリフェニルスルホニウム塩〕、等も有用である。 必要に応じてこれらの光酸発生剤を組み合わせて使用することもで きる。

本発明による感光性組成物は、上記光酸発生剤を、その種類及び用途に応じ、一般に変性ポリシルセスキアザン質量に対して0.05~50質量%の量で含有する。光酸発生剤の含有量が0.05質量%よりも少ないと、分解反応速度が極めて遅くなり、反対に50質量%よりも多くなると、変性ポリシルセスキアザン由来の特徴である緻密な膜が得難くなる。光酸発生剤は、変性ポリシルセスキアザン質量に対して0.1~20質量%、より好ましくは1~20質量%の量で含まれることが好ましい。

変性ポリシルセスキアザンと光酸発生剤とを含む感光性組成物を 一定期間以上保存しなければならない場合には、ニトロベンジルス

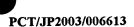


ルホン酸エステルをはじめとする一部の光酸発生剤については、保存時に変性ポリシルセスキアザンから遊離する微量のNH3によって分解されるおそれがある。このような場合には、耐塩基性の光酸発生剤を選択することにより感光性組成物の保存安定性が向上する。かかる耐塩基性の光酸発生剤としては、イミノスルホネート誘導体、ジスルホン誘導体、ジアゾメタン誘導体の他、4ーメトキシーαー((((4ーメトキシフェニル)スルホニル)オキシ)イミノ)ベンゼンアセトニトリルのようなスルホキシム系化合物及び下式の化合物のようなトリアジン系化合物が挙げられる。

本発明による感光性組成物はさらに形状安定化剤として水溶性化合物を含むことができる。ここで形状安定化剤とは、光照射部の除去により形成されるパターン断面の側壁をより急峻化させることができる剤をいう。



上述したように、本発明による変性ポリシルセスキアザンは光照 射によりSi-N結合が開裂し、次いで雰囲気中の水分と反応する ことによりシラノール結合が生成する。ところで、変性ポリシルセ スキアザンは疎水性が高いため、含水雰囲気に接した塗膜表面の近 傍ではシラノール結合の生成が速やかに起こる。しかし、含水雰囲 気に接していない塗膜内部では、塗布基板との界面に近いほど塗膜 表面から浸透してくる水分量が少なくなり、シラノール結合の生成 が起こりにくくなる。このため、変性ポリシルセスキアザン参膜は 、その表面から基板界面にかけて感光性が低下するような感度差を 有する。そうすると、塗膜表面に近いほどシラノール結合が生成し 易く、現像により溶解除去され易くなる。その結果、パターン断面 の側壁がなだらかとなり、この現象がパターンの微細化、あるいは 解像度の向上、を制限する一因となる。ここで、形状安定化剤とし て水溶性化合物を添加すると、パターン断面の側壁を急峻化させ、 解像度を高めることができる。すなわち、水溶性化合物を添加する ことにより感光性塗膜の疎水性が低下し、含水雰囲気に接している **塗膜表面から塗膜内部への水分のアクセスが促進される。このため** 塗膜の表面近傍と基板界面近傍との間のシラノール結合の生成速度 における差、すなわち感度差が小さくなる。そうすると、マスク開 口部に相当する塗膜部分を基板界面近傍まで十分に溶解除去させる のに必要な照射光エネルギーを低下させることができ、ひいてはマ スク遮蔽部分への「しみ出し光」のエネルギーを低下させることが できる。「しみ出し光」のエネルギーが変性ポリシルセスキアザン のSi-N結合を開裂させるには小さすぎる程度にまで低下した部 分は、当該「しみ出し光」により間接的に照射される部分であって も、シラノール結合が生成しないため現像時に溶解除去されること がない。その結果、マスク遮蔽部分における溶解除去部分が減少す



ることによりパターン断面の側壁が急峻化し、最も好ましくは、直 立する。

このようなパターン断面の側壁の急峻化が感光性組成物の感光度の高低に係わらず達成されることは容易に理解されよう。すなわち、基板近傍における感光性組成物の感光度が高くなる場合には、上述のように照射光エネルギーを低下させることによりパターン断面の側壁が急峻化される。また、例えば本発明による水溶性化合物の添加により感光性組成物の感光度が全体的に低下した場合には、マスク開口部に相当する塗膜部分を基板界面近傍まで十分に溶解除去させるのに必要な照射光エネルギーを高めなければならない場合もあり得るが、マスクに遮蔽されている変性ポリシルセスキアザン部分のSi-N結合を開裂させるのに必要な「しみ出し光」のエネルギーも同様に高くなるため、塗膜の感度差が小さければ、パターン断面の側壁は同様に急峻化する。要するに、感光性組成物の感光度の高低に係わらず、塗膜の表面近傍と基板界面近傍との間の感光度差を小さくすることにより、パターン断面の側壁が急峻化する。

当該水溶性化合物は、中性水に不溶であっても酸性水又は塩基性水に可溶であれば有用である。これは、酸性水に可溶であれば、輻射線照射部は光酸発生剤から生成した酸により酸性となるからであり、また塩基性水に可溶であれば、アルカリ水溶液による現像時に現像液の浸透性が促進されるからである。いずれの場合も塗膜表面から塗膜内部への水分のアクセスが促進され、よって塗膜の表面近傍と基板界面近傍との間の感度差が小さくなる。

本発明による水溶性化合物は、モノマーであってもポリマーであってもよい。当該水溶性化合物の水溶性の程度は、中性水、酸性水又は塩基性水のいずれかに対して約0.01g/100mL以上であればよく、必ずしも易溶である必要はない。なお、当該水溶性化



合物は、後述するように感光性組成物に均一に混合されることが好ましいので、変性ポリシルセスキアザンやその溶剤に対しても十分な混和性を示すことが必要である。

このような化合物の具体例として、2-ニトロアニリン、3-ニ トロアニリン、4-ニトロアニリン、2-ニトロー4-アミノトル エン、3-ニトロ-2-アミノトルエン、3-ニトロ-4-アミノ トルエン、4-ニトロ-2-アミノトルエン、5-ニトロ-2-ア ミノトルエン、6-ニトロ-2-アミノトルエン、4-ニトロベン ゼン-アゾ-オルチノール、1-(4-ニトロベンゼンスルホニル)-1H-1, 2, 4-トリアゾール、5-ニトロベンズイミダゾ ール、4-ニトロベンジルアセテート、2-ニトロベンジルアルコ ール、3-ニトロベンジルアルコール、4-ニトロベンジルアルコ ール、ニトロシクロヘキサン、1-ニトロプロパン、2-ニトロプ ロパン、ニフェジピン、2,7-ジニトロフルオン、2,7-ジニ トロー9ーフルオレノン、3,3'ージニトロベンゾフェノン、3 , 4′ージニトロベンゾフェノン、炭酸プロピレン、炭酸エチレン 、トリフルオロアセトアミドのようなアミド化合物、トリフルオロ 酢酸アンモニウム塩、水溶性アクリルポリマー、水溶性エポキシポ リマー、水溶性メラニンポリマー、等が挙げられる。特に好適な水 溶性化合物は、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニ トロアニリン、2-ニトロ-4-アミノトルエン、炭酸プロピレン 、炭酸エチレン及び水溶性アクリルポリマーである。

本発明による感光性組成物は形状安定化剤として水溶性化合物を変性ポリシルセスキアザン質量に対して0.01~50質量%の割合で含有することができる。個々の水溶性化合物の特性によって最適な混合比は異なるが、含有量が0.01質量%よりも少ないとパターン側壁の傾斜改善効果が小さく、反対に、50質量%よりも多



いと現像後の膜物性に瑕疵や強度不足などの問題を発生させる。水溶性化合物の変性ポリシルセスキアザン質量に対する含有量は、好ましくは0.05~40質量%、より好ましくは0.1~30質量%である。

本発明による感光性組成物の調製は、変性ポリシルセスキアザンに上記光酸発生剤を、所望により形状安定化剤としての水溶性化合物と共に、添加することにより行われる。光酸発生剤及び当該水溶性化合物を均一に混合することが好ましく、そのためには変性ポリシルセスキアザンと光酸発生剤及び当該水溶性化合物を十分に攪拌しながら混合することや、それぞれを後述の溶剤に溶かして希釈してから混合することが望ましい。特に、混合に際して光酸発生剤及び当該水溶性化合物が固体である場合には、これを溶剤に溶かしてから混合することが好ましい。添加時の温度や圧力に特に制限はなく、室温、大気圧下で添加を行うことができる。但し、光酸発生剤が励起されないよう、その添加時から後述の現像工程に至るまでは、使用する光酸発生剤の感光波長を含まない環境下、好ましくは暗所、で作業することが望ましい。

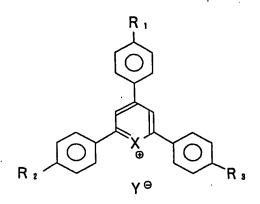
本発明による感光性組成物に増感色素を混合すると有利な場合がある。光酸発生剤によっては、例えば3,3',4,4'ーテトラ(tープチルペルオキシカルボニル)ベンゾフェノンのように、それ自体が励起される波長域が約330nmより短いものがある。光照射を、KrF系(248nm)、ArF系(193nm)、等のエキシマレーザーを使用して行う場合には、光酸発生剤が直接励起されるので増感色素は必要がない。しかしながら、高圧水銀灯(360~430nm)などの安価な光源を用いる場合には、当該波長域で励起される増感色素を組み合わせることにより間接的に光酸発生剤を励起させることができる。このように、増感色素を組み合わ



せることにより、本発明の感光性組成物は常用の安価な光源を用い たパターニングが可能となる。

本発明の感光性組成物に使用することができる増感色素として、 クマリン、ケトクマリン及びそれらの誘導体、チオピリリウム塩、 等、具体的には、p-ビス(o-メチルスチリル)ベンゼン、7-ジメチルアミノー4ーメチルキノロン-2、7-アミノー4ーメチ ルクマリン、4,6-ジメチル-7-エチルアミノクマリン、2-(p-ジメチルアミノスチリル) -ピリジルメチルヨージド、7-ジエチルアミノクマリン、7-ジエチルアミノー4-メチルクマリ ン、2,3,5,6-1H,4H-テトラヒドロ-8-メチルキノ リジノーく9, 9 a, 1-gh>クマリン、7-ジエチルアミノー 4-トリフルオロメチルクマリン、7-ジメチルアミノ-4-トリ フルオロメチルクマリン、7-アミノ-4-トリフルオロメチルク マリン、2,3,5,6-1H,4H-テトラヒドロキノリジノー < 9, 9 a, 1-gh>クマリン、7-エチルアミノー6-メチル -4-トリフルオロメチルクマリン、7-エチルアミノ-4-トリ フルオロメチルクマリン、2,3,5,6-1H,4H-テトラヒ ドロー 9 一カルボエトキシキノリジノー< 9 , 9 a , 1 - g h > 0マリン、3-(2'-N-メチルベンズイミダゾリル)-7-N, N-ジエチルアミノクマリン、N-メチル-4-トリフルオロメチ ルピペリジノ-<3,2-g>クマリン、2-(p-ジメチルアミ ノスチリル) -ベンゾチアゾリルエチルヨージド、3-(2'-ベ ンズイミダゾリル) -7-N, N-ジエチルアミノクマリン、3-(2' -ベンゾチアゾリル) -7-N, N-ジエチルアミノクマリ ン、並びに下式で表されるピリリウム塩及びチオピリリウム塩が挙 げられる。





X	R ₁	R 2	R ₃	Υ
		•		
S	OC4H3	Н	Н	BF₄
s	0C4H3	Н	Н	BF ₄
S	OC4H9	OCH₃	OCH₃	BF₄
s	H	0CH₃	OCH₃	BF₄
s	N(CH ₃) ₂	Н	Н	ClO ₂
0	OC4H9	Н	Н	SbF ₆

さらに別の増感色素の具体例として以下の化合物が挙げられる。

PCT/JP2003/006613

特に好適な増感色素は、7-ジエチルアミノー4ーメチルクマリン及び7-ジエチルアミノー4ートリフルオロメチルクマリンである。

増感色素を組み合わせる場合、本発明による感光性組成物中、上



記増感色素を、変性ポリシルセスキアザン質量に対して一般に 0.05~50質量%、好ましくは1~20質量%の量で含有させればよい。

本発明による感光性組成物に増感色素を混合した場合には、得られる被膜が着色することがある。しかしながら、本発明の感光性組成物を用いてパターニングされた層間絶縁膜を製作し、これを表示デバイスなどに適用する場合には、焼成後の層間絶縁膜が可視光に対して透明であることが必要なこともある。このような場合でも、本発明の感光性組成物に含まれる光酸発生剤が被膜焼成時に増感色素を分解して焼成後の層間絶縁膜を透明化することが可能である。

さらに、光反応には直接関与しないが、被膜焼成時に増感色素を分解せしめる酸化触媒を本発明の感光性組成物に別途添加することにより、一層透明な層間絶縁膜を得ることができる。このような酸化触媒の例として、プロピオン酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸パラジウム、酢酸子、白金微粒子などの金属の有機化合物や微粒子等が挙げられる。酸化触媒を添加する場合、本発明による感光性組成物中、変性ポリシルセスキアザン質量に対して一般に0.05~10質量%、好ましくは0.1~5質量%の量で含有させればよい。また、このような酸化触媒を添加することにより、不要な色素を分解し脱色する他、変性ポリシルセスキアザンのセラミックス化を促進することもできる。

溶剤を使用する場合には、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ジエチルベンゼン、トリメチルベンゼン、トリエチルベンゼン、等の芳香族化合物;シクロヘキサン;シクロヘキセン;デカヒドロナフタレン;ジペンテン;nーペンタン、iーペンタン、nーヘキサン、iーヘキサン、nーヘプタン、iーヘプタン、n



ーオクタン、iーオクタン、nーノナン、iーノナン、nーデカン、iーデカン、等の飽和炭化水素化合物;エチルシクロへキサン;メチルシクロへキサン;pーメンタン;ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、等のエーテル類;メチルイソブチルケトン(MIBK)等のケトン類;酢酸ブチル、酢酸シクロヘキシル、ステアリン酸ブチル、等のエステル類、等を使用することが好ましい。これらの溶剤を使用する場合、変性ポリシルセスキアザンの溶解度や溶剤の蒸発速度を調節するために、2種類以上の溶剤を混合してもよい

溶剤の使用量(割合)は、採用するコーティング方法により作業性がよくなるように選択され、また用いる変性ポリシルセスキアザンの平均分子量、分子量分布、その構造によって異なるので、適宜、自由に混合することができる。しかしながら、変性ポリシルセスキアザンの安定性や製造効率を考慮し、変性ポリシルセスキアザン濃度は0.1~50質量%、より好適には0.1~40質量%とすることが好ましい。

また、本発明による感光性組成物に、必要に応じて適当な充填剤及び/又は増量剤を加えることができる。充填剤の例としてはシリカ、アルミナ、ジルコニア、マイカを始めとする酸化物系無機物あるいは炭化珪素、窒化珪素等の非酸化物系無機物の微粉等が挙げられる。また用途によってはアルミニウム、亜鉛、銅等の金属粉末の添加も可能である。これら充填剤は、針状(ウィスカーを含む。)、粒状、鱗片状等種々の形状のものを単独又は2種以上混合して用いることができる。又、これら充填剤の粒子の大きさは1回に適用可能な膜厚よりも小さいことが望ましい。また充填剤の添加量は変性ポリシルセスキアザン1質量部に対し、0.05質量部~10質量部の範囲であり、特に好ましい添加量は0.2質量部~3質量部



の範囲である。

本発明の感光性組成物には、必要に応じて各種顔料、レベリング 剤、消泡剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、pH調整剤、分散剤、表面 改質剤、可塑剤、乾燥促進剤、流れ止め剤を加えてもよい。

本発明によると、上記感光性組成物を用いたパターン化層間絶縁膜の形成方法も提供される。すなわち、本発明の方法は、上記層間絶縁膜用感光性組成物の塗膜を形成する工程と、当該塗膜に光をパターン状に照射する工程と、当該塗膜の照射された部分を溶解除去する工程とを含んで成る。

本発明による感光性組成物の塗膜の形成は、一般的な塗布方法、即ち、浸漬、ロール塗り、バー塗り、刷毛塗り、スプレー塗り、フロー塗り、スピンコート、等の方法を採用し、シリコン基板、ガラス基板、等の適当な基板上で行うことができる。また、基材がフィルムである場合にはグラビア塗布も可能である。所望により塗膜の乾燥工程を別に設けることもできる。

塗膜は必要に応じて1回又は2回以上繰り返して塗布することにより所望の膜厚とすることができる。本発明によると、シラザン結合以外の結合基を選択することにより、膜厚限界が向上するので、クラックのない $5.0~\mu$ m以上、好ましくは $10.0~\mu$ m以上の厚さの層間絶縁膜を得ることができる。

本発明の感光性組成物の塗膜を形成した後、該塗膜を乾燥させ且つその後の脱ガス量を減少させるため、該塗膜をプリベーク(加熱処理)することが好ましい。プリベーク工程は、一般に $40\sim20$ 0 \mathbb{C} 、好ましくは $60\sim120\mathbb{C}$ の温度で、ホットプレートによる場合には $10\sim180$ 秒間、好ましくは $30\sim90$ 秒間、クリーンオーブンによる場合には $1\sim30$ 分間、好ましくは $5\sim15$ 分間、実施することができる。



本発明の感光性組成物の塗膜を形成し、必要に応じてプリベーク処理した後、該塗膜に光をパターン状に照射する。このような光源としては、高圧水銀灯、低圧水銀灯、メタルハライドランプ、エキシマレーザー、等を使用することができる。照射光としては半導体のような超微細加工を除き、360~430nmの光(高圧水銀灯)を使用することが一般的である。中でも、液晶表示装置の場合には430nmの光を使用することが多い。このような場合に本発明の感光性組成物に増感色素を組み合わせると有利であることは上述した通りである。

照射光のエネルギーは、光源や所期の膜厚にもよるが、一般に5~4000mJ/cm²、好ましくは10~2000mJ/cm²とする。このエネルギーが5mJ/cm²よりも低いと変性ポリシルセスキアザンが十分に分解せず、反対に4000mJ/cm²よりも高いと、露光過多となり、ハレーションの発生を招く場合がある。

パターン状に照射するためには一般的なフォトマスクを使用すればよく、そのようなフォトマスクについては当業者であれば周知である。

照射の際の環境は、一般に周囲雰囲気(大気中)や窒素雰囲気と すればよいが、変性ポリシルセスキアザンの分解を促進するために 酸素含有量を富化した雰囲気を採用してもよい。

パターン状に照射を受けた感光性組成物の露光部分では、変性ポリシルセスキアザンのSi-N結合が開裂し、雰囲気中の水分との反応することによりシラノール(Si-OH)結合が生成し、変性ポリシルセスキアザンが分解する。照射後の塗膜を現像することにより、感光性組成物の露光部分が除去され、未露光部分が基板上に残留してパターン(ポジ型)が形成される。残留する変性ポリシル



セスキアザンは後述の現像液にはほとんど膨潤しないので、照射光 のパターンと分解除去される変性ポリシルセスキアザンのパターン はほぼ完全に一致し、良好なパターン精度(解像度)が得られる。

変性ポリシルセスキアザン組成物の露光部分の除去、すなわち現像に際しては、現像液としてアルカリ水溶液を使用することができる。このようなアルカリ水溶液として、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH)、珪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、等の水溶液が挙げられる。本発明における現像では、業界標準のアルカリ現像液である約2%のTMAH水溶液を使用すると便利である。

現像に要する時間は、膜厚や溶剤にもよるが、一般に $0.1\sim5$ 分、好ましくは $0.5\sim3$ 分である。また、現像処理温度は、一般に $20\sim50$ ℃、好ましくは $20\sim30$ ℃である。

現像効率を高めるため、当該技術分野でいわゆる溶解防止剤として知られている化合物を本発明の感光性組成物に添加することができる。一般的な溶解防止剤は、その疎水性により、塗膜の未露光部においてポリマーがアルカリ現像液に溶出することを防止するが、露光部においては露光により又は光酸発生剤により溶解防止剤自体が分解して親水性となることによりポリマーの分解を促進する作用を有している。上述したように、本発明による変性ポリシルセスキアザンは現像液には溶解しないため、溶解防止剤の未露光部の溶出防止作用というメリットを享受することはほとんどないが、露光部の溶解促進作用が有利に働くことがわかった。すなわち、本発明の感光性組成物にいわゆる溶解防止剤を添加することにより、露光部の溶解速度が高くなるという点において、現像効率を向上させることができる。このような溶解防止剤の具体例として、 t ープトキシカルボニル (以下、t ーBOC) 化カテコール、t ーBOC化ヒド



ロキノン、ベンゾフェノン-4, 4'-ジカルボン酸 tーブチルエステル、4, 4'-オキシジ安息香酸 tーブチルエステル、等が挙げられる。溶解防止剤は、感光性組成物に対して0.1~40質量%、好ましくは1~30質量%の範囲で添加することができる。

現像により、感光性変性ポリシルセスキアザン組成物の露光部分が除去され、パターニングが完了する。パターン化された変性ポリシルセスキアザン膜を層間絶縁膜として使用するためには、長時間放置又は焼成することにより、高耐熱性、低誘電率、透明性、等に優れたシリカ系セラミックス被膜に転化させればよい。現像気に割ける場合、一般に周囲雰囲気は、1日以上、放置すればよい。また、焼成する場合には、焼成温度は、用いる変性ポリシルセスキアザンの種類や基板、電子部品、等の耐熱性にもよるが、一般に50~1000℃、好ましくは100~1000℃、より好主、好ましくは150℃~450℃とする。焼成時間は、一般に5分以上、好ましくは150℃~450℃とする。焼成雰囲気は、一般に周囲雰囲気(大気中)とすればよいが、変性ポリシルセスキアザンの酸化を促進するために酸素含有量及び/又は水蒸気分圧を富化した雰囲気を採用してもよい。

以下の実施例により本発明をさらに説明する。

比較例1

ガス吹き込み管、メカニカルスターラー及びジュワーコンデンサーを装着した四つ口フラスコの内部を乾燥窒素で置換した後、その中でメチルトリクロロシラン (CH₃ SiCl₃) をそのモノマー濃度が10

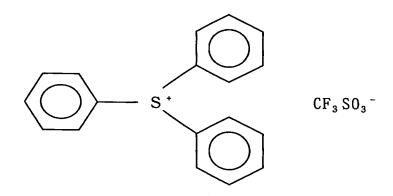


質量%となるようにピリジンで希釈した原料液を調製し、これを氷冷した。この原料液にアンモニア(NH₃)をガス吹き込み管から少量ずつ混入することによりアンモノリシス反応を起こさせた。

反応終了後、 $-(SiCH_3(NH)_{1.5})_n$ -で示されるポリマーが得られた。このポリマーの重量平均分子量(ポリスチレン換算)は4729であった。

次いで、ポリマーの溶媒置換を行いプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)溶液を得た。この溶液に、ポリマー質量に対して1質量%の下記光酸発生剤PAG-1を添加することにより、感光性組成物を得た。

PAG-1



比較例2

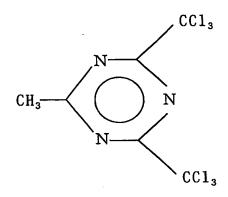
ガス吹き込み管、メカニカルスターラー及びジュワーコンデンサーを装着した四つロフラスコの内部を乾燥窒素で置換した後、その中でメチルトリクロロシラン(CH_3SiCl_3)と、これに対して5モル%のジフェニルクロロシラン(Ph_2SiCl_2)とをその全体モノマー濃度が10質量%となるようにピリジンで希釈した原料液を調製し、これを氷冷した。この原料液にアンモニア(NH_3)をガス吹き込み管から少量ずつ混入することによりアンモノリシス反応を起こさせた



反応終了後、 $-(SiCH_3(NH)_{1.5})_n$ -と $-(SiPh_2(NH))_n$ -で示される共 重合ポリマーが得られた。このポリマーの重量平均分子量(ポリスチレン換算)は4240であった。

次いで、共重合ポリマーの溶媒置換を行いキシレン溶液を得た。 この溶液に、ポリマー質量に対して2質量%の下記光酸発生剤PAG-2を添加することにより、感光性組成物を得た。

PAG-2



実施例1

ガス吹き込み管、メカニカルスターラー及びジュワーコンデンサーを装着した四つロフラスコの内部を乾燥窒素で置換した後、その中でメチルトリクロロシラン(CH_3SiCl_3)と、これに対して5 モル%の1,4-ビス(ジメチルクロロシリル)ベンゼン($C1Si(CH_3)_2PhSi(CH_3)_2C1$)とをその全体モノマー濃度が10質量%となるようにピリジンで希釈した原料液を調製し、これを氷冷した。この原料液にアンモニア(NH_3)をガス吹き込み管から少量ずつ混入することによりアンモノリシス反応を起こさせた。

反応終了後、 $-(SiCH_3(NH)_{1.5})_n$ -と $-(SiMe_2PhSiMe_2(NH))_n$ -で示される共重合ポリマーが得られた。このポリマーの重量平均分子量(ポリスチレン換算)は4866であった。

次いで、共重合ポリマーの溶媒置換を行いPGMEA溶液を得た。こ



の溶液に、ポリマー質量に対して 2 質量%の上記光酸発生剤PAG-2を添加することにより、感光性組成物を得た。

実施例2

ガス吹き込み管、メカニカルスターラー及びジュワーコンデンサーを装着した四つロフラスコの内部を乾燥窒素で置換した後、その中でメチルトリクロロシラン(CH_3 Si Cl_3)と、これに対して5モル%の1,7-ジクロロヘキサメチルトリシロキサン(Cl Si $(CH_3)_2$ OSi $(CH_3)_2$ OSi $(CH_3)_2$ OSi $(CH_3)_2$ C1)とをその全体モノマー濃度が10質量%となるようにピリジンで希釈した原料液を調製し、これを氷冷した。この原料液にアンモニア(NH_3)をガス吹き込み管から少量ずつ混入することによりアンモノリシス反応を起こさせた。

反応終了後、 $-(SiCH_3(NH)_{1.5})_n$ -と $-(SiMe_2OSiMe_2OSiMe_2(NH))_n$ -で示される共重合ポリマーが得られた。このポリマーの重量平均分子量(ポリスチレン換算)は4438であった。

次いで、共重合ポリマーの溶媒置換を行いPGMEA溶液を得た。この溶液に、ポリマー質量に対して2質量%の上記光酸発生剤PAG-2を添加することにより、感光性組成物を得た。

実施例3

ガス吹き込み管、メカニカルスターラー及びジュワーコンデンサーを装着した四つロフラスコの内部を乾燥窒素で置換した後、その中でメチルトリクロロシラン(CH_3 SiCl $_3$)と、これに対して5モル%のジメチルジクロロシラン((CH_3) $_2$ SiCl $_2$)と、10モル%の1、4-ビス(ジメチルクロロシリル)ベンゼン(C1Si(CH_3) $_2$ PhSi(CH_3) $_2$ Cl)とをその全体モノマー濃度が10質量%となるようにピリジンで希釈した原料液を調製し、これを氷冷した。この原料液にアンモニア(NH_3)をガス吹き込み管から少量ずつ混入することによりアンモノリシス反応を起こさせた。



反応終了後、 $-(SiCH_3(NH)_{1.5})_n$ -と $-(SiMe_2(NH))_n$ -と $-(SiMe_2PhSiMe_2(NH))_n$ -で示される共重合ポリマーが得られた。このポリマーの 重量平均分子量(ポリスチレン換算)は4388であった。

次いで、共重合ポリマーの溶媒置換を行いPGMEA溶液を得た。この溶液に、ポリマー質量に対して2質量%の上記光酸発生剤PAG-2を添加することにより、感光性組成物を得た。

上記の各感光性組成物について、保存安定性、膜厚限界、膜硬度 及び感光性を以下のように測定した。

・保存安定性

各感光性組成物をその濃度が40質量%になるように調製し、容量100 mLのガラス瓶に入れて密封した。各ガラス瓶を50℃に設定した恒温オーブンに5日間保管した。保管前後のポリマー重量平均分子量を比較することにより、感光性組成物の安定性を評価した。ポリマー分子量の増加率が低いほど、感光性組成物は安定である。

・膜厚限界

ガラス基板に対し500 rpmのスピンコートで所望の膜厚が得られる濃度の感光性組成物を準備した。 3μ mより 0.5μ m刻みで塗膜を形成し、90 \mathbb{C} で1分間プリベーク処理した後、低圧水銀灯により塗膜全面に100 mJ/cm² の照射を行った。その塗膜を30 \mathbb{C} 、80% R H の加湿環境に 5 分間曝した後、これに 200 \mathbb{C} で 3 分間ポストベーク処理を施し、最後に 300 \mathbb{C} で 30 分間焼成を行った。基板を室温に冷却した後、光学顕微鏡に 10 で 10 の有無を確認した。下記表中の膜厚限界値は、クラックの無い最大膜厚を示す。

・膜硬度

各感光性組成物について、上述の方法により膜厚 1 μ m の 3 0 0 ℃焼成膜を準備した。これらの硬度をJIS K 5400 8.4鉛筆硬度測定法により測定した。



・感光性 (感度)

各感光性組成物を、シリコン基板上に反射防止膜として薄膜の窒化珪素を堆積させたものの上に、膜厚が $0.8\,\mu$ mになるように塗布した。各塗膜を $1.00\,^{\circ}$ で9.0秒間プリベーク処理した後、KrF 露光機に装填し、 $0.25\,\mu$ mのライン&スペースパターンが得られるフォトマスクを介して、露光量を変化させながら照射を行った。次いで、 $4.0\,^{\circ}$ C、 $8.0\,^{\circ}$ R Hの加湿環境に3.0分間曝した後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(TMAH)水溶液に1.0分間接触させ、最後に純水で洗浄を行った。

電子顕微鏡により、所望の 0.25μ mのパターン線幅が得られる露光量を感度と定義した。露光量が足りない場合にはライン幅が広がり(すなわち、スペース幅が狭まり)、反対に露光量が多すぎるとライン幅が狭まる(すなわち、スペース幅が広がる)。感度の数値が低いほど、感光性は高い。

						1
		比較例1	比較例 2	実施例1	実施例 2	実施例3
		, , , , ,			00.	000
	加助储	4729	4240	4866	4438	4388
	Ŕ	2011			00,,	0007
母七女	計略後	7675	2080	4902	4487	4388
7	Ş				1 1 1	/ 20/ 0
	海上幅 (級)	2946(+62%)	840(+20%)	36(+1%)	49(+1%)	0(0%)
	4 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			l l	0
	瞠 写 阴 界	3.5 mm	$4.0 \mathrm{m}$	10.0μ m	5.5 μ m	10.0μ π
7	メチャン			1		113
	腾 雁 庄	2H	2H	НS	ЭН	Эп
	なされ		-	6 , =	6 / + 4 7	2 - 1 / - 2
	咸光体	$15m.1/cm^{2}$	$60mJ/cm^2$	25mJ/cm ²	ISmJ/cm~	mo/fmcz
	71 07 50					



表1より、ポリシルセスキアザンの構成単位の一部をシラザン結合以外の結合基に代替した実施例1~3は、そのような結合基をもたない比較例1及び2に比べて、保存安定性が顕著に高いことがわかる。同様に、実施例1~3は、比較例1及び2に比べて、膜厚限界が向上していることに着目すべきである。さらに、これら実施例1~3の性能向上は、膜硬度をポリマと比べて、膜原限が2.5倍も向上していることに着目すべきである。となく達成されていることもわかる。特に、ベンゼン環をポリマー主鎖に含む実施例1~3の性能向上は、感光性を著しく損なって、膜硬度が2.5倍も向上していることに着目すべきである。その上、これら実施例1~3の性能向上は、感光性を著しく損なってとなく実現していることがわかる。むしろ、ベンゼン環を側鎖に含む比較例2と比べて、感光性が向上していることに着目すべきである。

産業上の利用可能性

このように、ポリシルセスキアザンの構成単位の一部をシラザン結合以外の結合基に代替することにより、感光性や得られる層間絶縁膜の硬度を損なわずに、感光性組成物の保存安定性を高めることができ、さらに当該代替結合基を選択することにより、得られる層間絶縁膜の膜厚限界を高めることができる。しかも、得られる絶縁膜は低誘電率特性を有し、耐磨耗性等の機械特性にも優れ、層間絶縁膜として優れた特性を備えた微細パターンの形成を可能にする。

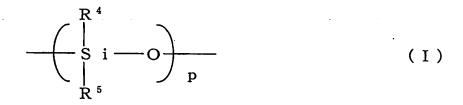


請求の範囲

1.一般式:-[SiR¹(NR²)_{1.5}]-(式中、R¹は、各々独立に、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)を基本構成単位とし、その最大で50モル%をシラザン結合以外の結合基に代替してなる重量平均分子量500~200,000変性ポリシルセスキアザン及び光酸発生剤を含むことを特徴とする層間絶縁膜用感光性組成物。

2. 前記変性ポリシルセスキアザンが、さらに一般式: $-[SiR^3]$ NR2] - 及び/又は $[SiR^3]$ (NR2) $_{0.5}$] -(式中、 R^3 は、各々独立に、水素、炭素数 1 \sim 3 のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、 R^2 は、各々独立に、水素、炭素数 1 \sim 3 のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)で表される他の構成単位を前記基本構成単位に対して 0.1 モル% \sim 1 0 0 モル% 含有する、請求の範囲第 1 項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。

3. 前記結合基が下記一般式 (I):



(式中、R⁴ 及びR⁵ は、各々独立に、水素、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルキルシリル基又はアルコキシ基を表し、pは1~



10の整数を表す)で表される、請求の範囲第1項又は第2項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。

4. 前記結合基が下記一般式 (II) :

$$\begin{array}{c|c}
R^{6} \\
S & i \\
R^{7}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{8} \\
S & i \\
R^{9}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{8} \\
S & i \\
R^{9}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{8} \\
S & i \\
R^{9}
\end{array}$$

(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルキルシリル基又はアルコキシ基を表し、R¹⁰は酸素原子、アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、アルキルイミノ基又はアルキルシリレン基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、qは1~10の整数を表す)で表される、請求の範囲第1項又は第2項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。

- 5. R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹がメチル基であり、R¹⁰がフェニレン基であり、R²が水素であり、そしてqが1である、請求の範囲第4項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- 6. 前記光酸発生剤がスルホキシム系化合物及びトリアジン系化合物からなる群より選ばれたものである、請求の範囲第1項~第5項のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- 7. さらに t ーブトキシカルボニル化カテコール、 t ーブトキシカルボニル化ヒドロキノン、ベンゾフェノンー 4, 4'ージカルボン酸 t ーブチルエステル及び 4, 4'ーオキシジ安息香酸 t ーブチルエステルからなる群より選ばれた溶解防止剤を、前記感光性組成



物に対して0.1~40質量%含む、請求の範囲第1項~第6項のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。

- 8. さらに形状安定化剤としてニトロ基又は炭酸エステルを含有する水溶性化合物を含む、請求の範囲第1項~第7項のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- 9. さらに増感色素を含む、請求の範囲第1項~第8項のいずれか1項に記載の層間絶縁膜用感光性組成物。
- 10. 一般式: [SiR¹(NR²)_{1.5}] (式中、R¹は、各々独立に、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表し、R²は、各々独立に、水素、炭素数1~3のアルキル基又は置換もしくは無置換フェニル基を表す)を基本構成単位とし、その最大で50モル%をシラザン結合以外の結合基に代替してなる重量平均分子量500~200,000変性ポリシルセスキアザン及び光酸発生剤を含む層間絶縁膜用感光性組成物の塗膜を形成し、前記塗膜に光をパターン状に照射し、前記塗膜の照射された部分を溶解除去し、そして残留したパターン化塗膜を周囲雰囲気において放置又は焼成することを特徴とするパターン化層間絶縁膜の形成方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/06613

A. CLASSI Int.C	FICATION OF SUBJECT MATTER :1 ⁷ G03F7/075, 7/004, H01L21/02	7, C08G77/54, 77/62			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Int.(Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G03F7/004-7/18, C08G77/54, 77/62 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Jitsu Kokai	yo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho Toroku Jitsuyo Shinan Koho	o 1996–2003 o 1994–2003		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Category*	Citation of document, with indication, where appr	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y A	WO 00/20927 A1 (TONEN CORP.), 13 April, 2000 (13.04.00), Full text; all drawings & EP 1164435 A1 & JP	2000-181069 A	1,9,10 2,6-8 3-5		
Y A	WO 02/19037 A1 (CLARIANT INTE 07 March, 2002 (07.03.02), Full text; all drawings & EP 1239332 A1 & JP	3-5 2002-107937 A			
A	JP 8-245880 A (Tonen Corp.), 24 September, 1996 (24.09.96) Full text (Family: none)	•	1-10		
Furt	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "E" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document is taken alone of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an invention observe the document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an invention observe the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document of particular relevance; the claimed invention observe the document observe th			the application but cited to idenlying the invention e claimed invention cannot be lered to involve an inventive ne e claimed invention cannot be tep when the document is ch documents, such on skilled in the art		
Date of the	Date of the actual completion of the international search 25 June, 2003 (25.06.03) Date of mailing of the international search 08 July, 2003 (08.07.03)				
Jap	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile		Telephone No.			
Form PC	T/ISA/210 (second sheet) (July 1998)	·			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/06613

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A A	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP 9-115348 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 02 May, 1997 (02.05.97), Full text (Family: none)	Relevant to claim No. 1-10

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/06613

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl⁷ G03F7/075, 7/004,

H01L21/027,

C08G77/54, 77/62

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1⁷ G03F7/004-7/18, C08G77/54, 77/62

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
X	WO 00/20927 A1 (TONEN CORPORAT	1, 9, 10		
	ION) 2000.04.13,全文,全図 & EP 1164			
	435 A1 & JP 2000-181069 A			
Y		2, 6-8 $3-5$		
A		3 - 5		
Y	WO 02/19037 A1 (CLARIANT INTERN	1, 2,		
1	ATIONAL LTD.) 2002.03.07,全文,全図	6 - 10		
	& EP 1239332 A1 & JP 2002-1079			
A	3 7 A	3 - 5		

区欄の続きにも文献が列挙されている。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25.06.03

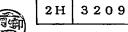
国際調査報告の発送日

08.07. **03**

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 前田 佳与子



電話番号 03-3581-1101 内線 3229



国際出願番号 PCT/JP03/06613

	ENVIRORETA EN LA SANTA ENTRE EN LA SANTA E			
C (続き) . 引用文献の	関連すると認められる文献 関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
A	JP 8-245880 A (東燃株式会社) 1996.09.24,全文 (ファミリーなし)	1-10		
A	JP 9-115348 A (住友電気工業株式会社) 1997.05.02,全文 (ファミリーなし)	1-10		
	·	•		
L				

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)